

## 信頼性試験結果

製品名：S-82D1Axx-A8T2U7

搭載パッケージ：HSNT-8(1616)

| No. | 試験名                     | 試験条件                                                                    | 時間          | r/n  | 故障判定基準                                               |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| 1   | 高温動作                    | Ta=125 °C, V = Vopr max.                                                | 1000 h      | 0/22 | 製品規格を満足すること                                          |
| 2   | 高温高湿バイアス #1             | Ta=85 °C, RH=85 %<br>V = Vopr max.                                      | 1000 h      | 0/22 | 製品規格を満足すること                                          |
| 3   | プレッシャクッカ・バイアス #1        | Ta=125 °C, RH=85 %, P=2×10 <sup>5</sup> Pa<br>V = Vopr max.             | 100 h       | 0/22 | 製品規格を満足すること                                          |
| 4   | 高温保存                    | Ta=150 °C                                                               | 1000 h      | 0/22 | 製品規格を満足すること                                          |
| 5   | 低温保存                    | Ta=-65 °C                                                               | 1000 h      | 0/22 | 製品規格を満足すること                                          |
| 6   | 温度サイクル (気相) #1          | Ta=150 °C ⇔ -65 °C, 各 15 分                                              | 500 cycles  | 0/22 | 製品規格を満足すること                                          |
| 7   | はんだ耐熱性 (リフロー) #2        | T=260 °C, 10s                                                           | 3 回         | 0/22 | 製品規格を満足すること<br>外観上、異常がなきこと                           |
| 8   | はんだ付け性 #3               | T=245 °C<br>はんだ材：Sn-3.0Ag-0.5Cu                                         | 5 s         | 0/11 | ゼロクロスタイムが3秒以内<br>であること<br>半田浸漬部分の95%以上が<br>半田で覆われること |
| 9   | ウイスカ 1 (室温保存)           | Ta=30 °C, RH=60%                                                        | 4000h       | 0/6  | ウイスカサイズが 40 μm 以下<br>であること                           |
| 10  | ウイスカ 2 (温度サイクル)         | Ta=85 °C ⇔ -40 °C                                                       | 1500 cycles | 0/6  | ウイスカサイズが 45 μm 以下<br>であること                           |
| 11  | ウイスカ 3 (高温高湿保存)         | Ta=55 °C, RH=85 %                                                       | 4000h       | 0/6  | ウイスカサイズが 40 μm 以下<br>であること                           |
| 12  | はんだ接合信頼性<br>(せん断強度) #3  | Ta=125 °C ⇔ -40 °C<br>はんだ材：Sn-3.0Ag-0.5Cu                               | 2000 cycles | 0/22 | 初期強度値の50%以上の<br>強度を維持すること                            |
| 13  | 静電耐圧 1(HBM)             | V=±2000 V, C=100 pF, R=1.5 kΩ<br>V <sub>DD</sub> 基準, V <sub>SS</sub> 基準 | 5 回         | 0/5  | 製品規格を満足すること                                          |
| 14  | 静電耐圧 2(CDM)             | V=±500 V 帯電, 接地放電                                                       | 1 回         | 0/5  | 製品規格を満足すること                                          |
| 15  | ラッチアップ強度1<br>(パルス電流注入法) | ±100 mA, V = Vopr max.                                                  | 1 回         | 0/5  | ラッチアップしないこと                                          |
| 16  | ラッチアップ強度2<br>(電源過電圧法)   | V = Vopr max.から規定の過電圧                                                   | 1 回         | 0/5  | ラッチアップしないこと                                          |

注) Vopr max.=最大動作電圧

#1,2,3：前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

| 前 処 理（#1）           |                                |                               |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 高温保存                | 吸湿処理                           | 熱 処 理                         |
| Ta=125 °C<br>t=24 h | Ta=85 °C<br>RH=85 %<br>t=168 h | リフロー3 回<br>T=260 °C<br>t=10 s |

| 前 処 理（#2）           |                               |     |
|---------------------|-------------------------------|-----|
| 高温保存                | 吸湿処理                          | 熱処理 |
| Ta=125 °C<br>t=24 h | Ta=85 °C<br>RH=85%<br>t=168 h | —   |

| 前 処 理（#3） |                               |     |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 高温保存      | 吸湿処理                          | 熱処理 |
| —         | Ta=105 °C<br>RH=100%<br>t=8 h | —   |